

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2025-007

转债代码：118048

转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

2024 年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）业绩预告情况

1、经广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2024 年度将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-5,200 万元至-7,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 7,372.08 万元到 9,172.08 万元，同比减少 339.40%到 422.27%。

2、预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5,500 万元至-7,500 万元；与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 6,637.16 万元到 8,637.16 万元，同比减少 583.66%到 759.54%。

（三）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

2023 年度，归属于母公司所有者的净利润：2,172.08 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：1,137.16 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司 2024 年预计亏损的主要原因如下：

（1）报告期内，由于消费终端需求有所好转，推动部分品类的消费类（如 AIoT、智能手机、存储、卫星通信等）客户测试需求增加，相关芯片测试收入同比大幅增长；但受高算力、工业控制、通信等测试需求减少的影响，使该类型测试收入出现不同程度的较大下滑，综合使得营业收入不及预期。

(2) 报告期内，营业成本端由于前期布局的产能逐渐释放，使折旧、摊销、人工、电力、厂房费用等固定成本持续上升；另一方面，由于消费类芯片出货量较去年同期大幅增长，相应辅料用量增加导致成本增加。

(3) 报告期内，随着可转换公司债券发行，有息负债较上年同期大幅增加，使得相关财务费用大幅增长。

(4) 报告期内，公司前期并购的控股子公司东莞市千颖电子有限公司主营业务为集成电路测试方案开发、晶圆测试服务与集成电路测试相关的配套服务，受宏观市场和行业环境影响，经营业绩不及预期，出现商誉减值迹象，公司进行充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，按照企业会计准则的要求，计提了适当的商誉减值准备，对公司本期利润造成一定的影响。

(5) 报告期内，公司高度重视研发体系的建设，始终坚定不移地高研发投入，坚持人才自主培养与科学搭建研发架构，提高研发团队协同性，确保研发工作高效推进。公司持续深耕集成电路测试方案开发，为公司未来营业收入增长提供研发技术支持与保障。

(6) 为实施公司战略部署，满足长远发展需求，提升市场竞争力，公司中高端测试和晶圆磨切产能持续投入，但使得相关成本费用和资金需求显著增加，短期影响公司的利润。

面对挑战与机遇，公司管理层快速响应及决策，充分发挥自身在技术研发方面的优势，持续优化业务结构，不断强化核心竞争力。2024 年度，公司提出以“独立第三方晶圆测试、芯片成品测试等技术服务”为主体，以“晶圆激光开槽、隐切、减薄等技术服务”为左翼，以“无人驾驶的全天候超宽光谱叠层图像传感芯片等技术服务”为右翼，旨在打造“一体两翼”的战略布局。

公司积极开拓行业知名设计企业并建立稳定的战略合作关系。现已取得初步成效，新拓展和存量客户新产品项目陆续导入，预计随着未来营业收入增加，将有效提升整体盈利能力，有利于公司长期发展。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。目前公司不存在对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2024 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日